

研究成果報告書 (掲載期間 2024. 11. 1-2026. 3. 31)

学会発表

- (1) 小舘直人, 内田圭, 永治仁, 松本昌樹, 山田靖, 横井祐人, 富田結翔, 大竹ちひろ: 高破壊靱性の AlN 基板を用いた温度サイクル高信頼性と高放熱性を両立した Cu 張基板, エレクトロニクス実装学会, 第 39 回春期講演大会, 2025 年 3 月, 東京.

学外競争的研究資金獲得

- (1) 内田圭, 山田靖: 中小企業経営支援等対策費補助金, 成長型中小企業等研究開発支援事業, パワー半導体の高密度実装に対応した高放熱セラミックス基板の開発, 2023~2025.